



**Toshiba stellt eine Entwicklungsplattform für seine 130nm Fit Fast Structured Arrays vor**

*Hohe Leistungsfähigkeit, niedriger Stromverbrauch und geringere Kosten*

**Düsseldorf, 13. November 2018** – Toshiba Electronics Europe (Toshiba) gibt die erste Auslieferung seiner neuen FFSA™- Entwicklungsplattform (Fit Fast Structured Array) für den 130nm-Fertigungsprozess bekannt. Die neue hochleistungsfähige Plattform für die SoC-Entwicklung (System-on-Chip) ermöglicht kundenspezifische Lösungen mit einem niedrigen Stromverbrauch und zu geringen Kosten.

Toshiba bietet ASIC- (Application Specific IC) und FFSA-Plattformen, die sich an die marktbezogenen und technischen Anforderungen der Kunden anpassen lassen, um somit effiziente Lösungen für die kundenspezifische SoC-Entwicklung bereitzustellen. Durch einen neuen Ansatz verfügen alle FFSAs über einen gemeinsamen siliziumbasierten Master-Layer, der zusammen mit den oberen Metall-Layern verwendet wird, die reserviert sind und die kundenspezifische Anpassung des Arrays ermöglichen.

Die FFSA-Plattform erfüllt die Anforderungen der Kunden hinsichtlich hoher Leistungsfähigkeit bei geringem Stromverbrauch. Da die Anpassung der Bausteine auf die Metall-Layer-Masken beschränkt ist, verringern sich die Entwicklungskosten erheblich. Dadurch lassen sich Muster und Serienstückzahlen wesentlich schneller ausliefern, als bei herkömmlichen ASICs. Kunden, die die FFSA-ASIC-Designmethodik und -bibliothek verwenden, erzielen eine höhere Leistungsfähigkeit bei geringerem Stromverbrauch als dies mit (vergleichbaren) FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) möglich ist.

Der neue FFSA-130nm-Prozess wird zu Toshiba's aktuellen 28-, 40- und 65nm-Prozessen hinzugefügt, womit eine weitere Option für industrielle Anwendungen zur Verfügung steht. Der FFSA-130nm-Node-Prozess erlaubt verschiedene Master-Layer für bis zu 664KB RAM und etwa 912.000 Gatter pro Baustein.

Auf der Plattform entwickelte Bausteine werden von Japan Semiconductor hergestellt, einer Tochtergesellschaft der Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation mit langjähriger Erfahrung in der Fertigung von ASICs, ASSPs und Mikrocomputern. Dies stellt eine langfristige Versorgung sicher und erfüllt oder übertrifft die Betriebskontinuitätsplanung bei den Kunden.

Bausteine, die auf dem neuen FFSA-130nm-Prozess basieren, bieten die Leistungsfähigkeit und hohe Integration, die für unterschiedlichste Märkte erforderlich ist, u.a. für Industrieanlagen, Kommunikations-, Bürotechnik etc.

Weitere Informationen über die neue Entwicklungsplattform von Toshiba unter:

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/custom-soc/platform/ffsa.html>

Anmerkungen:

[1] Die Zahl der verfügbaren Gatter gilt als Richtlinie und variiert je nach Anwendung

\*FFSA™ ist eine Marke der Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

\*Alle anderen Firmen-, Produkt- und Servicenamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

###

## Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist der europäische Geschäftszweig für elektronische Komponenten [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

Zum Hauptsitz in Düsseldorf gehören Zweigstellen in Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Von dort aus werden Design, Marketing und Vertrieb bereitgestellt. Präsident des Unternehmens ist Mr. Tomoaki Kumagai.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

## Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0

Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail: [solution-marketing@toshiba-components.com](mailto:solution-marketing@toshiba-components.com)

## Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

## Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

November 2018

Ref. 7178/A